

恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

- 恒烁半导体（合肥）股份有限公司拟向银行申请总额度不超过人民币20,000万元的综合授信额度。
- 本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月6日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

随着公司业务规模的进一步扩大，为满足公司生产经营和业务发展的需要，提高资金运营能力，公司拟向银行申请总额度不超过人民币20,000万元的综合授信额度，授信种类包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、保理、保函、信用证、抵（质）押贷款等各种融资业务，具体授信业务品种、额度和期限以银行最终核定为准。

该综合授信事项有效期为董事会审议通过之日起12个月内，在授权范围和有效期内，上述授信额度可循环滚动使用。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。公司本次向银行申请综合授信额度事项不涉及对外担保或关联交易。

为提高效率，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度内与银行签署相关的合同及法律文件，并由公司财务部负责具体实施。

特此公告。

恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会

2023年1月7日